



中華民國專利證書

發明第 I557833 號

發明名稱：用於積體電路單元嚙合的總成與方法

專利權人：洛科系統有限公司

發明人：楊海春、丁鐘才、張德春、林仲振

專利權期間：自 2016 年 11 月 11 日至 2030 年 12 月 22 日止

上開發明業經專利權人依專利法之規定取得專利權

經濟部智慧財產局 局長

洪淑敏

中華民國



105

年

11

月

11

日

(TRANSLATION)

THE REPUBLIC OF CHINA PATENT CERTIFICATE
INVENTION PATENT NO. I557833

Title of Invention: ASSEMBLY AND METHOD FOR IC UNIT ENGAGEMENT

Patentee(s): Rokko Systems Pte Ltd

Inventor(s): YANG, HAE CHOON
JUNG, JONG JAE
JANG, DEOK CHUN
LIM, CHONG CHEN GARY

Patent Duration: from 11 November 2016 to 22 December 2030

The Patentee has obtained the patent right in accordance with the Patent Act.

Intellectual Property Office

Date: 11 November 2016

(Official Seal of the
Intellectual Property Office
Ministry of Economic Affairs)